

Product Change Notice (PCN)

件名: RH850/F1K シリーズのウェハプロセス、ウェハテスト拠点追加

発行日: 1/17/2024

出荷開始予定日: 8/30/2024

改版履歴: 初版

変更内容の説明:

後工程：ATJ 熊本にて量産中の RH850/F1K シリーズを対象として、ウェハプロセス、ウェハテスト拠点の追加を行います。

1) ウェハプロセス拠点追加：那珂工場 Renesas Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Naka Factory)

2) ウェハテスト拠点追加：那珂工場 Renesas Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Naka Factory)

生産拠点の組合せ(生産フロー)及び製品仕様の詳細は、付録欄をご参照下さい。

尚、生産拠点につきましては、生産能力を考慮の上、弊社にて判断させていただきます。

ATJ：Amkor Technology Japan, Inc.

対象製品リスト:

付録欄“対象製品リスト”をご参照ください。

変更の理由:

製品の安定供給のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

本変更による外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法:

ラベル、マークにて識別可能です。詳細は、付録欄をご参照下さい。

信頼性データについて:

2024 年 3 月 8 日以降に提示可能です。

サンプル出荷予定日:

4/26/2024

製品/材料の化学物質データ:

弊社営業へお問合せください。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

付録
製品リスト

PCN#[HDL2-0324]
PC-MCU-A021A/J

RH850/F1K シリーズ

R7F7015423AFD-C#BA3	R7F7015623AFD-C#KA3	R7F7015824AFD-C#BA3	R7F7016104AFD-C#KA3
R7F7015423AFD-C#KA3	R7F7015624AFD-C#BA3	R7F7015824AFD-C#KA3	R7F7016113AFD-C#BA3
R7F7015424AFD-C#BA3	R7F7015624AFD-C#KA3	R7F7015833AFD-C#BA3	R7F7016113AFD-C#KA3
R7F7015424AFD-C#KA3	R7F7015633AFD-C#BA3	R7F7015833AFD-C#KA3	R7F7016114AFD-C#BA3
R7F7015433AFD-C#BA3	R7F7015633AFD-C#KA3	R7F7015834AFD-C#BA3	R7F7016114AFD-C#KA3
R7F7015433AFD-C#KA3	R7F7015634AFD-C#BA3	R7F7015834AFD-C#KA3	R7F7016123AFD-C#BA3
R7F7015434AFD-C#BA3	R7F7015634AFD-C#KA3	R7F7015863AFD-C#BA3	R7F7016123AFD-C#KA3
R7F7015434AFD-C#KA3	R7F7015663AFD-C#BA3	R7F7015863AFD-C#TA3	R7F7016124AFD-C#BA3
R7F7015463AFD-C#BA3	R7F7015663AFD-C#TA3	R7F7015864AFD-C#BA3	R7F7016124AFD-C#KA3
R7F7015463AFD-C#TA3	R7F7015664AFD-C#BA3	R7F7015864AFD-C#TA3	R7F7016133AFD-C#BA3
R7F7015464AFD-C#BA3	R7F7015664AFD-C#TA3	R7F7015873AFD-C#BA3	R7F7016133AFD-C#KA3
R7F7015464AFD-C#TA3	R7F7015673AFD-C#BA3	R7F7015873AFD-C#TA3	R7F7016134AFD-C#BA3
R7F7015473AFD-C#BA3	R7F7015673AFD-C#TA3	R7F7015874AFD-C#BA3	R7F7016134AFD-C#KA3
R7F7015473AFD-C#TA3	R7F7015674AFD-C#BA3	R7F7015874AFD-C#TA3	R7F7016203AFD-C#BA3
R7F7015474AFD-C#BA3	R7F7015674AFD-C#TA3	R7F7015973AFD-C#BA3	R7F7016203AFD-C#KA3
R7F7015474AFD-C#TA3	R7F7015773AFD-C#BA3	R7F7015973AFD-C#TA3	R7F7016204AFD-C#BA3
R7F7015573AFD-C#BA3	R7F7015773AFD-C#TA3	R7F7015974AFD-C#BA3	R7F7016204AFD-C#KA3
R7F7015573AFD-C#TA3	R7F7015774AFD-C#BA3	R7F7015974AFD-C#TA3	R7F7016213AFD-C#BA3
R7F7015574AFD-C#BA3	R7F7015774AFD-C#TA3	R7F7016023AFD-C#BA3	R7F7016213AFD-C#KA3
R7F7015574AFD-C#TA3	R7F7015803AFD-C#BA3	R7F7016023AFD-C#KA3	R7F7016214AFD-C#BA3
R7F7015603AFD-C#BA3	R7F7015803AFD-C#KA3	R7F7016024AFD-C#BA3	R7F7016214AFD-C#KA3
R7F7015603AFD-C#KA3	R7F7015804AFD-C#BA3	R7F7016024AFD-C#KA3	R7F7016223AFD-C#BA3
R7F7015604AFD-C#BA3	R7F7015804AFD-C#KA3	R7F7016033AFD-C#BA3	R7F7016223AFD-C#KA3
R7F7015604AFD-C#KA3	R7F7015813AFD-C#BA3	R7F7016033AFD-C#KA3	R7F7016224AFD-C#BA3
R7F7015613AFD-C#BA3	R7F7015813AFD-C#KA3	R7F7016034AFD-C#BA3	R7F7016224AFD-C#KA3
R7F7015613AFD-C#KA3	R7F7015814AFD-C#BA3	R7F7016034AFD-C#KA3	R7F7016233AFD-C#BA3
R7F7015614AFD-C#BA3	R7F7015814AFD-C#KA3	R7F7016103AFD-C#BA3	R7F7016233AFD-C#KA3
R7F7015614AFD-C#KA3	R7F7015823AFD-C#BA3	R7F7016103AFD-C#KA3	R7F7016234AFD-C#BA3
R7F7015623AFD-C#BA3	R7F7015823AFD-C#KA3	R7F7016104AFD-C#BA3	R7F7016234AFD-C#KA3

製品仕様

項目		現状	拠点追加後
製品型名		変更無し	
製品外形		LQFP-100pin, 144pin, 176pin	← (変更無し)
前工程	拡散拠点	TSMC	TSMC, 那珂
	ウェハテスト拠点	TeraPower	TeraPower, 那珂
後工程	組立拠点	ATJ 熊本	← (変更無し)
マーク		変更有り (マーク仕様参照)	
ラベル		変更有り (ラベル仕様参照)	

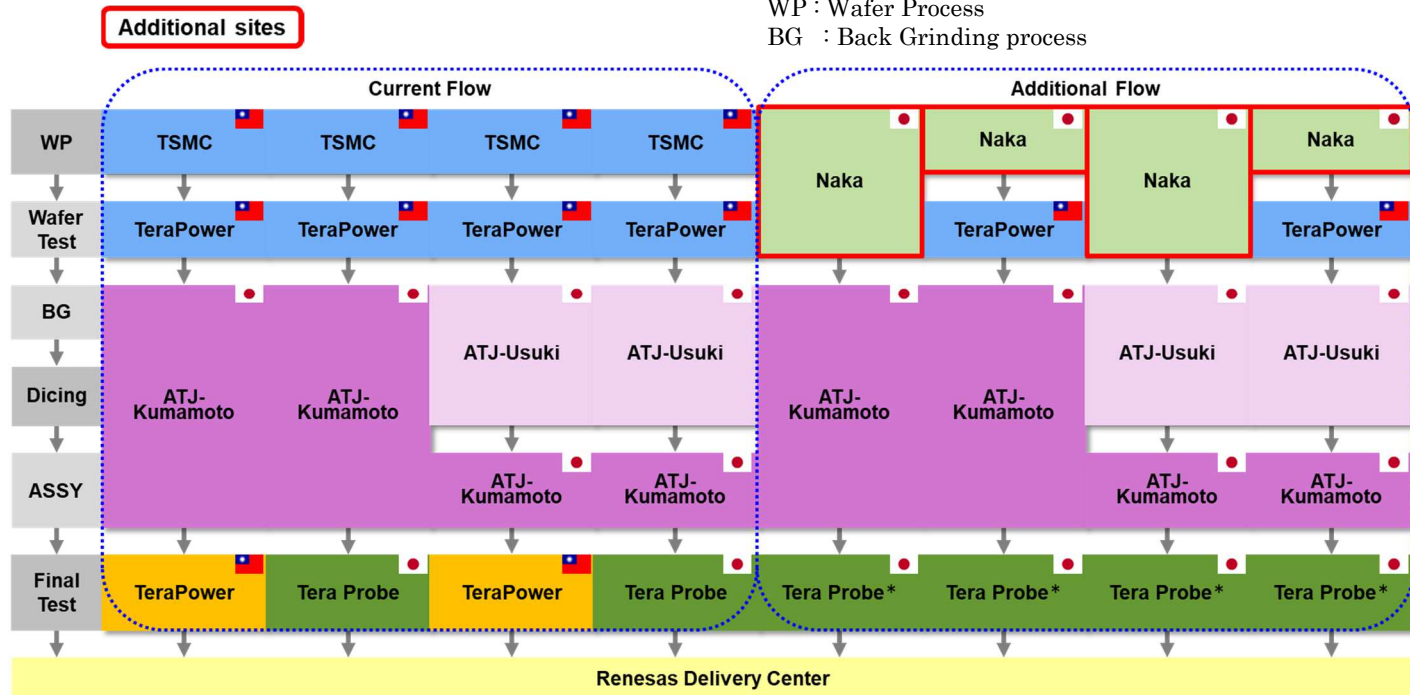
項目		TSMC 品	那珂品	備考
前工程	ウェハ	TSMC ウェハ	那珂ウェハ	
	プロセス	RV40F (40nm) プロセス A (TiN/SiO2/SiN)	RV40F (40nm) プロセス B (SiON/SiO2/SiN)	TOP-Metal の材料変更
後工程	ダイボンド材	ダイボンド材 A	←	
	リードフレーム	リードフレーム A	←	
	ワイヤ	Cu ワイヤ A	←	
	モールド樹脂	Cu ワイヤ用樹脂 A	←	
	メッキ	純 Sn	←	

生産フロー

TSMC : Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

WP : Wafer Process

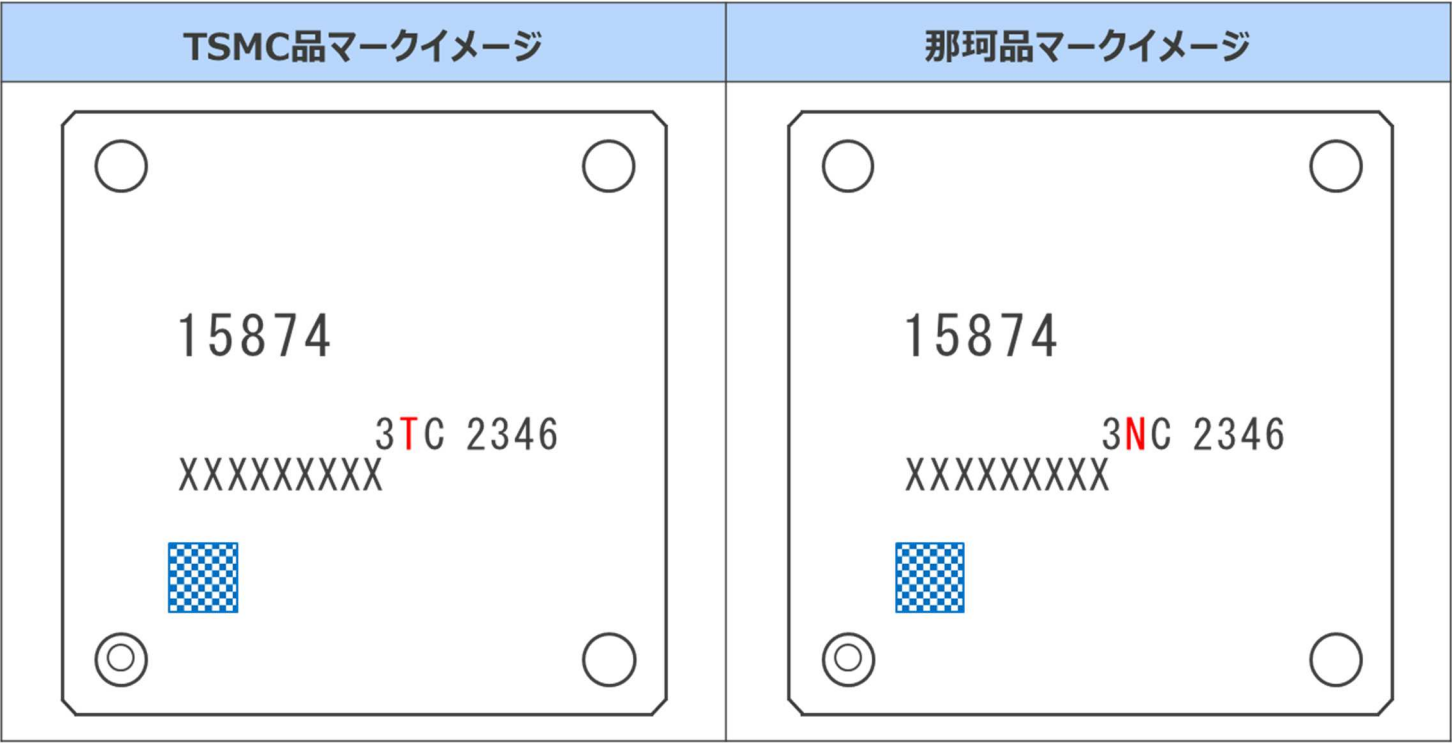
BG : Back Grinding process



* Additional Flow の Final Test 拠点到 TeraPower は含まれません。

マーク仕様：
 マーク印字例：R7F7015874AFD-C#BA3（F1K 176pin）
 那珂品は赤文字部分が異なります。

PCN#[HDL2-0324]
PC-MCU-A021A/J



ラベル仕様：
 ラベル印字例：R7F7015874AFD-C#BA3（F1K 176pin）
 那珂品は赤文字部分が異なります。

